PACIFIC TRINETICS
CORPORATION

STACKING SYSTEM

Semi- Automatic



LTCC/HTCC 회로 및 유사 회로 제작용제품

실험실과 같이 소량 다품종 환경에 가장 적합합니다.

시범 규모 생산 단순성과 유연한 작동에 중점을 둡니다.

모든 부품은 동일한 적재대에서 가공됩니다.

PTC 스태커 (반자동)

PTC 반자동 SA/ST 시리즈는
이 제품은 LTCC/HTCC 제조업체의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설 계되었으며, 회로 제작을 위해 미가공 상태의 판재를 적층 및 접착하는 데 적 합합니다.

이 시스템의 독자적인 소프트웨어와 비전 정렬 시스템은 ± 10 마이크론의 기계적 적층 정확 도를 보장합니다. SA와 ST 모두 최대 0.4인치(10mm)의 적층 두께를 자랑합니다.

판재를 느슨하게 접합하기 위해 SA 시리즈는 층을 쌓아 올리는 동안 판재 전체 표면을 가접 하는 방식을 사용하는 반면, ST 시리즈는 각 판재의 모서리를 이전 층에 용접하는 다중 지 점 용접 시스템을 사용합니다.

터치스크린 방식의 레시피 기반 모니터를 통해 작업자는 접착 온도와 시간을 완벽하게 제어 할 수 있습니다. 마일라 필름에서 분리된 녹색 테이프를 로딩 스테이지에 놓습니다. 스테이지 가 정렬 위치로 이동합니다. 자동 비전 정렬 시스템이 용지 표면의 기준점을 감지하여 용지 를 정렬합니다. 정렬된 용지는 진공 헤드로 집어 올려 적재 스테이지에 놓습니다.

가접은 전체 판재를 이전 층에 눌러 붙이거나 적층된 판재의 둘레를 따라 여러 지점을 용접하 는 방식으로 이루어집니다.

SA 및 ST 시리즈는 정확하고 간편하며 신뢰할 수 있는 작동을 위해 설계되었습니다.

개요

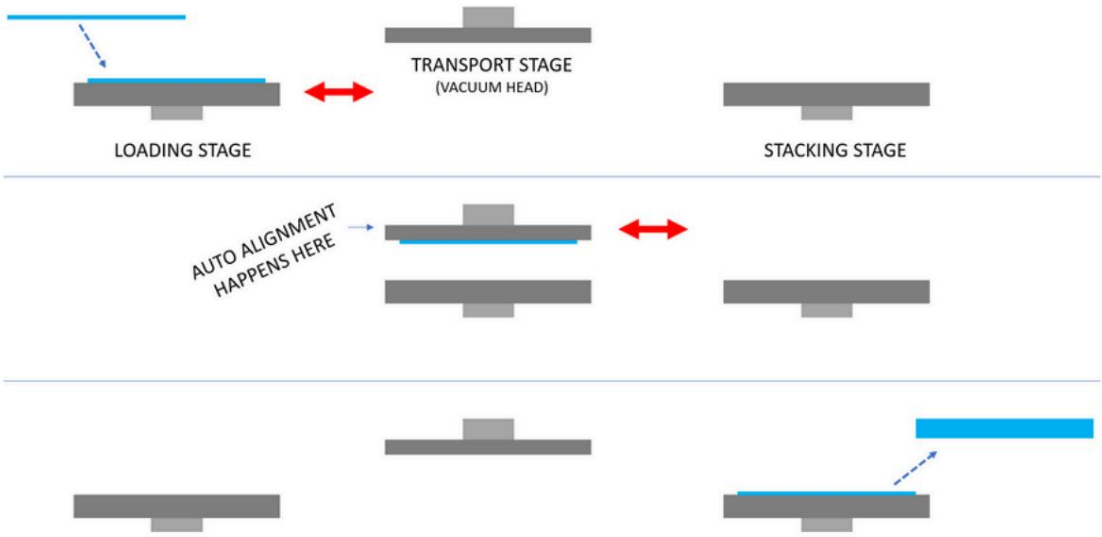
- LTCC/HTCC 제작용
  기기 및 이와 유사한 것들
- 간단한 작동
- 수동으로 마일라 필름 제거하기
- L자형 입력/출력
  구성
- 높은 정확도의 판금 정렬
  +/- 0.1mm (기계적)
- 2를 통한 빠른 시야 정렬
  CCD 카메라 및 PTC
  독점 소프트웨어
- 최초 설계부터 최종 설계까지 회로 제작 -
  마지막 또는 마지막에서 첫 번째
- 최대 적층 두께는 0.40인치입니다.
  (10mm)
- 접착 온도 85°C
  SA 시리즈 및 용접 지점
  ST 시리즈의 온도는 180°C입니다.



명세서

최대 레이어 수:	36 TYP.
적층 두께:	최대 두께는 11mm이며, 더 두껍게 제작 가능한 경우 제조사에 문의하십시오.
압박 압력:	420kN 더 높은 압력이 필요할 수 있습니다. 공장에 문의하십시오.
태킹템프:	SA 시리즈: 85°C, ST 시리즈: 180°C (용접점 기준)
주기 시간:	18초, 층층이
비전 정렬:	고해상도 CCD 카메라 2대
스태킹 정확도:	+/- 10uM (기계적 오차)
마일라 제거:	수동
레이어 계산:	오토매틱
컴퓨터 인터페이스	윈도우 기반 독점 운영 체제 UI

적층 공정



Inside the PTC Stacker

